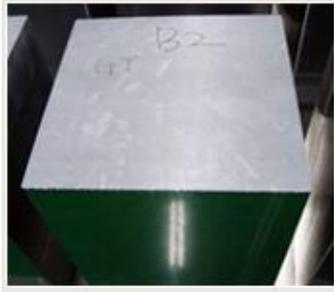
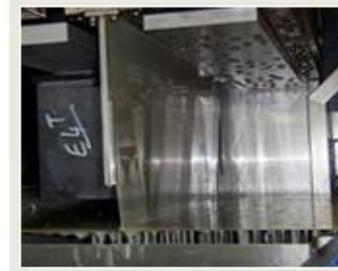


# 太陽能晶柱/錠切片代工

## Multicrystalline Wafer Process in S.H.(上海)



1. 切割成錠狀，  
角度會盡可能小。



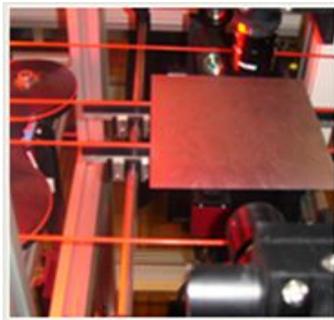
2. 載入方塊進入自  
動化線切割機器。



3. 將被切割成  
Wafers的方塊  
放進清洗機，並  
做第一階段清洗。



4. 當第一階段清洗完成  
時，同時Wafers會被分  
成一片一片。而且每塊  
wafer都會經歷使用超  
音速震動和清洗液的最  
終密集清洗過程。



5. 已清洗過的  
wafers現經歷有  
效的測試(TTV,  
WARP, Lifetime,  
Crack, etc.)



6. 多晶矽wafer